

【Characteristics】 A bubble is entrapped in an FPC coverlay.

【原因・判断ポイント・発生工程】カバーレイ接着剤の中に存在する揮発性物質が、カバーレイ製造中の熱により気化したり、微細な気泡が成長して出来たもの（カバーレイ製造工程）

【原因、判断要点、发生工序】在覆盖层压合过程，粘结剂中存在的挥发性物质在热的作用下汽化，生成细微气泡所引起的（覆盖层制造工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
A volatile substance contained in coverlay adhesive is evaporated by heat during coverlay manufacturing or an existing small bubble in the coverlay grows bigger. (Coverlay manufacturing process)



【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
FPC  
Magnification: ×



【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
FPC  
Magnification: ×

### 2-3-2-12 SR 狭隙部割れ／SR 在狭隙部位的裂痕／Solder resist cracking in a narrow area

【特徴】狭隙部のSRパターンが白化している状態の欠陥

【特征】SR 图形在狭隙部位有晕圈的缺陷。

【Characteristics】 A solder resist in a narrow area is whitened.

【原因・判断ポイント・発生工程】狭隙部にSRインクが十分に充填されなかったため、SR乾燥時の熱ストレスやその後の物理的負荷、衝撃などにより出来たもの（SR乾燥工程以降）

【原因、判断要点、发生工序】在狭隙部位由于SR油墨填充不足，在干燥时的热应力、以及事后的物理负荷、冲击等的作用下所引起的（SR干燥工序后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
As a narrow area is not fully filled with solder resist ink, thermal stress induced during curing, physical load or shock given in the subsequent processes creates the defect. (After solder resist application)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
Magnification: ×